

## 물성분석 기준단가[2017년도]

분석 분야	분석 내용	단가 (단위:원)
SIMS	O <sub>2</sub> <sup>+</sup> primary ion source 사용	357,000
	- 추가 시료 1개 당	214,000
	Cs primary ion source 사용	500,000
	- 추가 시료 1개 당	268,000
	추가 : Spectrum 측정 및 해석	178,000
	- 정량화 (1원소)	90,000
	- 추가 시료 1개 당	54,000
	- Depth 추가 4um 이상 분석 시 : 초과 2um 마다	54,000
	- Cs+ 이차 양이온 및 음이온 동시 분석 : 추가 시료 1개 당	54,000
	High mass resolution (HMR)	90,000
	- 추가 시료 1개 당	54,000
	미소부위 분석 (약 100um)	53,000
	유전물질 (절연체)	125,000
Image mapping	90,000	
표면처리 (Au coating)	44,000	
AES	Spectrum (point analysis, 1시야, 4point, SEM 1장)	222,000
	추가 시료 1개 당	142,000
	추가 : 표면식각	54,000
	Depth profile (0.5 um, 90분 기준)	268,000
	- 매 1시간 추가 분석 시	214,000
	Image mapping (1원소당, 60분 기준)	214,000
	- 매 1시간 추가 분석 시	214,000
	동일 시야 내 spectrum 1 point 추가	90,000
	동일 시야 내 line scan 1 line 추가	90,000
	고 분해능 Zalar rotating	107,000
	미소 부위 분석 (1um 이하)	107,000
	Sample heating (1point 당)	178,000
	두께 및 농도 환산	71,000
	분말 시료 분석	71,000
유전물질 (절연체) 전처리	90,000	
ESCA	Spectrum survey (wide/narrow scan)	222,000
	추가 : 표면식각	54,000
	Depth profile (2시간 기준)	323,000
	- 매 1시간 추가 분석 시	214,000
	Angle resolved (1angle 당)	54,000
	Monochromatic XPS	71,000
	Sample heating (1point)	178,000
	절연체 depth	71,000
	Curve fitting	54,000
	- Data 처리 (30분 추가 시)	54,000
	정량분석 (표준시료 제공 시)	161,000
	분말시료	71,000
	UPS 분석	134,000
TEM	TEM image 10만배 이하, 3시야 (BF 또는 DF)	270,000
	추가 시료 1개 당	255,000
	추가 High resolution lattice image	170,000

## 물성분석 기준단가[2017년도]

분석 분야	분석 내용	단가 (단위:원)
	추가 이미지 1개 당	34,000
	Micro-diffraction pattern	119,000
	기준배율 1시야 당	51,000
	특정영역 회절상 (SAD pattern)	51,000
	EDX 분석 (정성분석)	85,000
	EDX 분석 (정량분석)	85,000
	EDX element mapping	340,000
SEM	SEM image 관찰	60,000
	- Gold/Pt 코팅 시 (1회 : 3개 시료)	10,000
	매 30분 추가 관찰 시	44,000
	추가 image 1개당	3,000
	- 매 30분 추가 관찰 시	44,000
	EDX 정성분석	27,000
	EDX 정량분석 (5원소 이하)	17,000
XRD	Wide angle. (WAG) or Thin film diff. (TFD)	54,000
	- 추가 : 시료 1개 당	44,000
	DXRD 분석 (Rocking curve, 대칭, 단층 기준)	90,000
	- 추가 : 시료 1개 당	70,000
	- 추가 : DXRD 비대칭 (0, 180)	35,000
	결정구조 판독	107,000
시료제작	Si 재료의 단순 단면시료	240,000
	화합물 반도체 시료의 단순 단면시료	300,000
	추가 : 특정 부위 관찰용 시료	107,000
	SEM/AES/ESCA 관찰용 단면시료	90,000
패키징	Sawing	46,000
	Die Bonding	46,000
	Wire Bonding	46,000
	Lapping	46,000
	Polishing	46,000
	SRP (시료제작 포함)	60,000

\* 원외 물성분석, 패키징 단가는 내부 기준 단가의 30% 할인